

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.91元。本次公开发行募集资金总额为185,458.87万元，扣除总发行费用19,062.15万元（不含增值税），募集资金净额为166,396.72万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于2022年11月7日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

公司以前年度已累计使用募集资金100,056.36万元，本年度实际使用募集资金19,835.53万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为52,180.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为7,180.39万元，与募集资金余额相差45,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	158,569,195.04

项目	金额
减：本年度投入募集资金总额	198,355,293.32
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	-1,407,629.89
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-100,000,000.00
加：本年度对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	10,182,367.28
募集资金专项账户期末余额	71,803,898.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构中信证券及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司已开立的募集资金专户情况如下：

单位：万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	2,846.64	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.25	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	3,239.60	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.38	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	816.52	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金 10,214.00 万元，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具《关于有研半导体硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2300402 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目各项先期投入进行置换，明细如下：

单位：元

项目名称	截至 2023 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	置换金额
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	57,511,327.42	57,511,327.42
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	35,824,527.50	35,824,527.50
发行费用	8,804,094.35	8,804,094.35
合计	102,139,949.27	102,139,949.27

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使

用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	25,000.00	2025.12.24-2026.03.26	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	15,000.00	2025.12.18-2026.03.20	否
浦发银行北京分行	结构性存款	浮动收益	5,000.00	2025.12.31-2026.03.26	否

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》。同意使用超募资金 4,833 万元用于新建 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目。

报告期内，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2025 年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》。同意公司将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金 11,922 万元用于新建“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”，原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体情况见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2025 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及管理情况进行披露。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《有研半导体硅材料股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0089 号）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了有研硅 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对有研硅首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金

使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在违规使用募集资金的情形。

（以下为本报告附表）

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额(注 1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额				198,355,293.32		
变更用途的募集资金总额				119,220,000.00		已累计投入募集资金总额				1,198,918,912.95		
变更用途的募集资金总额比例				7.16%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	66,834,670.16	247,814,701.35	-10,013,398.65	96.12	不适用	不适用	不适用	不适用
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	84,775,561.23	338,327,243.15	-46,497,056.85	87.92	2025 年 12 月 (注 5)	不适用	不适用	否
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	有	357,347,600.00	238,127,600.00	238,127,600.00	43,058,780.13	188,154,999.06	-49,972,600.94	79.01	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目	无	-	119,220,000.00	119,220,000.00	770,281.80	770,281.80	-118,449,718.20	0.65	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	195,439,293.32	775,067,225.36	-224,932,774.64	77.51	—	—	—	—
超募资金永久补流(注 2)	无	不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	-	385,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购(注 2)	无	不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	-	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化(注 2)	无	-	48,330,000.00	48,330,000.00	2,916,000.00	2,916,000.00	-45,414,000.00	6.03	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000,000.00	1,469,265,687.59	1,469,265,687.59	198,355,293.32	1,198,918,912.95	-270,346,774.64	81.60	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见附注 4						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内，公司未发生此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内，公司未发生此情况						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						报告期内，公司未发生此情况						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						报告期内，公司未发生此情况						

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2: 截至 2025 年 12 月 31 日止, 超募资金总额 663,967,265.37 元, 其中 385,000,000.00 元用于永久补流, 35,935,687.59 元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购, 2,916,000.00 元用于 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目。

注 3: 由于本公司未承诺截至期末投入金额, 此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 4: 未达到计划进度原因主要基于以下因素: 第一, 受市场需求变动的影 响, 本公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化, 使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二, 本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则, 本公司适当调整了投资节奏。“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”已于 2025 年 12 月结项, 本公司 8 寸硅片产能已达到 25 万片/月。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响, 开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响, 加之贸易战导致刻蚀材料出口下滑, 本公司经过审慎研究, 决定对该项目进行调整。

注 5: “集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”已于 2025 年 12 月结项, 截至期末投入进度为 87.92%, 系部分尾款尚未结清等。

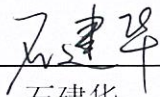
附表 2：变更募集资金投资项目情况表：

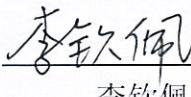
金额单位：人民币元

发行名称			2022 年首次公开发行股份募集资金												
募集资金到账日期			2022 年 11 月 7 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	集成电路刻蚀设备	生产建设	山东有研半导体材料有限公司	山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号	238,127,600.00	238,127,600.00	43,058,780.13	188,154,999.06	79.01	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 10 月 27 日	2025 年 11 月 12 日
集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目	用硅材料项目	生产建设	山东有研半导体材料有限公司	山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号	119,220,000.00	119,220,000.00	770,281.80	770,281.80	0.65	2026 年 12 月	不适用	不适用			
合计					357,347,600.00	357,347,600.00	43,829,061.93	188,925,280.86	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					于 2025 年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》，基于当前市场环境的深入分析，结合本公司发展战略，同意本公司将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金人民币 11,922 万元(占实际募集资金净额的 7.16%)用于新建“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”，并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》(公告编号：2025-035)。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响，加之贸易战导致刻蚀材料出口下滑，本公司经过审慎研究，决定对该项目进行调整。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


石建华


李钦佩

